POSITIVE TYPE PHOTOSENSITIVE ANION ELECTRODEPOSITION COATING RESIN COMPOSITION, ELECTRODEPOSITION COATING BATH USING THE SAME, PREPARATION OF RESIST PATTERN AND PRODUCTION OF PRINT CIRCUIT BOARD

Publication number: JP5117557
Publication date: 1993-05-14

Inventor:

TACHIKI SHIGEO; KO MASAHIKO; AKAHORI

SATOHIKO; KATO TAKURO

Applicant:

HITACHI CHEMICAL CO LTD

Classification:

- international:

C23F1/00; C09D5/44; C25D13/06; C25D13/10; G03F7/004; G03F7/039; H05K3/06; C09D5/44; C23F1/00; C09D5/44; C25D13/04; C25D13/10; G03F7/004; G03F7/039; H05K3/06; C09D5/44; (IPC1-7): C09D5/44; C23F1/00; C25D13/06; C25D13/10;

G03F7/004; G03F7/039; H05K3/06

- European:

Application number: JP19920011190 19920124

Priority number(s): JP19920011190 19920124; JP19910007989 19910125

Report a data error here

Abstract of JP5117557

PURPOSE:To obtain the subject composition containing a specific compound, capable of forming a good resist pattern free from an undeveloped part, having excellent light sensitivity and high resolution and useful for electrodeposition coating bath. CONSTITUTION:The objective composition containing a compound of formula I [R<1> is H, halogen, OH, alkyl or alkoxy; R<2> is H, OH, alkyl, ester, phenyl, etc.; (n) is 1-3] and/or a compound of formula II [R<4> is H, alkyl or phenyl; (n) is 1-3]. Furthermore, the compound is preferably used at an amount of 0.5-8 pts.wt., based on 100 pts.wt. of the composition.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(51) Int.Cl.5

識別記号

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平5-117557

技術表示箇所

(43)公開日 平成5年(1993)5月14日

C09D 5/44	PRN 7211-4J				
C23F 1/00	102 7179-4K				
C 2 5 D 13/06	В				
13/10					
G03F 7/00	4 501				
		審査請求 未請求 請求項の数5(全 10 頁) 最終頁に続く			
(21)出願番号		(71)出願人 000004455			
		日立化成工業株式会社			
(22)出顧日	平成4年(1992)1月24日	東京都新宿区西新宿2丁目1番1号			
		(72)発明者 立木 繁雄			
(31)優先権主張番号	号 特顧平3-7989	茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化			
(32)優先日	平 3 (1991) 1 月25日	成工業株式会社茨城研究所内			
(33) 優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者 廣 昌彦			
		茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化			
		成工業株式会社茨城研究所内			
		(72)発明者 赤堀 聡彦			
		炎城県日立市東町四丁目13番1号 日立化			
		成工業株式会社茨城研究所内			
		(74)代理人 弁理士 若林 邦彦			
	·	最終頁に続く			

(54) [発明の名称] ポジ型感光性アニオン電着塗料樹脂組成物、これを用いた電着塗装浴、レジストパターンの製造 法、プリント回路板の製造法及びプリント回路板

(57)【要約】

【目的】 現像残りのない良好なレジストパターンを形成できるポジ型感光性アニオン電着強料樹脂組成物を提供すること。

*【構成】 下記一般式(I)及び/又は(II)で表わ される化合物 【化1】

(I)

(式中、R¹は水素原子、ハロゲン原子、水酸基、アルキル基又はアルコキシ基を示し、R²は水素原子、水酸基、アルキル基、エステル基、フェニル基又は-X-R³ (ただし、Xはカルボキシル基で置換されていてもよいアルキレン基、シクロアルキレン基又はアルキレンエ※

※一テル基を示し、R³は水酸基、アルコキシ基、カルボキシル基又はジアルキルアミノ基を示す)を示し、nは1~3の整数(ただし、R³中にカルボキシル基を有する場合には0でもよい)を示す) 【化2】

(HOOC) N N N - R

(II)

(式中、 R^1 は一般式 (I) の R^1 と同じであり、 R^4 は 水素原子、アルキル基又はフェニル基を示し、nは $1\sim$ 3の整数を示す)を含有してなるポジ型感光性アニオン 電着登科樹脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

* 表わされる化合物

(化1)

(I)

(式中、R1は水素原子、ハロゲン原子、水酸基、アル 基、アルキル基、エステル基、フェニル基又は-X-R ■ (ただし、Xはカルポキシル基で置換されていてもよ いアルキレン基、シクロアルキレン基又はアルキレンエ※

※一テル基を示し、RIは水酸基、アルコキシ基、カルボ キル基又はアルコキシ基を示し、R²は水素原子、水酸 10 キシル基又はジアルキルアミノ基を示す)を示し、nは 1~3の整数(ただし、R2中にカルポキシル基を有す る場合には0でもよい)を示す)

2

【化2】

(式中、R¹は一般式(I)のR¹と同じであり、R⁴は 3の整数を示す)を含有してなるポジ型感光性アニオン 重着塗料樹脂組成物。

【請求項2】 請求項1記載のポジ型感光性アニオン電 着塗料樹脂組成物を含む電着塗装浴。

【請求項3】 請求項2記載の電着塗装浴に導電性基体 を陽極として浸漬し、通電により電着塗装して導電性基 体上に電滑塗装膜を形成し、その後活性光線を前記電着 塗装膜に画像状に照射し、露光部を現像により除去する ことによりレジストバターンを形成させることを特徴と するレジストパターンの製造法。

【請求項4】 請求項3記載の製造法を工程に含むこと を特徴とするプリント回路板の製造法。

【請求項5】 請求項4記載の製造法により製造された プリント回路板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ポジ型感光性アニオン 電着塗料樹脂組成物、これを用いた電着塗装浴、レジス トパターンの製造法、プリント回路板の製造法及びプリ ント回路板に関する。

[0002]

【従来の技術】プリント回路板を製造するに際しては、 まず基板上に光硬化性樹脂組成物の層を形成し、ついで 活性光線を画像状に照射し、未硬化部分を現像除去し、 レジストバターンを形成している。この工程において、 光硬化性樹脂組成物の層の形成には、種々の方法が採用 されている。何えばディップコート、ロールコート、カ ーテンコート等の光硬化性樹脂組成物溶液(塗液)を用 いる方法、あるいは光硬化性樹脂組成物のフィルム(感 光性フィルム)を積層する方法が知られている。これら 50 されている。

の方法のうち、感光性フィルムを積層する方法は、簡便 水素原子、アルキル基又はフェニル基を示し、nは1~ 20 に均一な厚みの光硬化性樹脂組成物の層が形成できるこ とから、現在主流の方法として採用されている。

(II)

[0003]

【発明が解決しようとする課題】最近、プリント回路板 の高密度、高精度化が進むに伴い、レジストパターンは より高品質のものが必要となってきている。即ち、ピン ホールがなく、下地の基板表面によく密着したレジスト バターンであることが望まれている。かかる要求に対し て、現在主流となっている感光性フィルムを積層する方 法では限界のあることが知られている。この方法では、 30 基板製造時の打痕、研磨の不均一性、基板内層のガラス 布の網目、表面への銅めっきのピット等の不均一等によ って生起する基板表面の凹凸への追従性が乏しく、十分 な密着性を得ることが困難である。この困難はフィルム の積層を減圧下で行うこと(特公昭59-3740号公 報参照) によって回避できるが、これには特殊で高価な 装置が必要となる。

【0004】このようなことが理由となって、近年再び ディップコート、ロールコート、カーテンコート等の溶 液塗工の方法が見直されるようになってきた。 しかしこ 40 れらの強工法では膜厚の制御が困難、膜厚の均一性が不 十分、ピンホールの発生等の問題がある。

【0005】そこで最近新たな方法として電着塗装によ り感光膜を形成する方法が提案されている(特開昭62 -235496号公報参照)。この方法によると①レジ ストの密着性が向上する、②基板表面の凹凸への追従性 が良好である、③短時間で膜厚の均一な感光膜を形成で きる、④塗液が水溶液のため、作業環境の汚染が防止で き、防災上にも問題がない等の利点がある。そのため最 近これに適する電着浴の組成に関して幾つかの提案がな

--584--

【0006】特にスルーホールを有するプリント回路板 の製造に有効と考えられるポジ型感光性アニオン電着登 料については、従来からいくつかの提案がなされてき た。一例をあげるとキノンジアジド基をポリマー鎖中に 導入した威光材料を含む系(特願平1-238437号 公報、特願平2-12853号公報)やポリマー結合剤 とキノンジアジド基を分子内に複数個有する化合物とを 混合した感光材料を含む系(特願平1-238434号 公報、特願平2-46853号公報)などが挙げられ る。

【0007】しかしながら、これらポジ型感光性アニオ ン電着塗料系では、電着塗装時に銅張積層板から溶出し た銅イオンがレジスト材料中のカルボキシル基とキレー*

$$(HOOC)_{n} \xrightarrow{R^{1}} N_{\parallel \atop N}$$

キル基又はアルコキシ基を示し、R1は水素原子、水酸 基、アルキル基、エステル基、フェニル基又は-X-R 1 (ただし、Xはカルボキシル基で置換されていてもよ いアルキレン基、シクロアルキレン基又はアルキレンエ※ *ト形成し、疑似的な架構をするため露光後の工程でアル カリ液で現像する際に露光部を十分に現像できない(以 下、現像残りと称す)という問題があった。

【0008】本発明は、上記問題を解決し現像残りのな い良好なレジストパターンを形成できるポジ型感光性ア ニオン電着塗料樹脂組成物、これを用いた電着塗装浴、 レジストパターンの製造法、プリント回路板の製造法及 びプリント回路板を提供するものである。

[0.0.0 9] 10 【課題を解決するための手段】本発明は、下記一般式 (1) 及び/又は(11) で表わされる化合物 [化3]

(1)

(式中、R1は水素原子、ハロゲン原子、水酸基、アル 20%ーテル基を示し、R3は水酸基、アルコキシ基、カルボ キシル基又はジアルキルアミノ基を示す)を示し、nは 1~3の整数(ただし、R2中にカルポキシル基を有す る場合には0でもよい)を示す)

(4:4)

$$(HOOC)_{n} \qquad N \qquad (II)$$

 $(式中、<math>R^1$ は一般式(I)の R^1 と同じであり、 R^4 は 30 ジド基を分子内に複数個有する化合物とを混合した感光 水素原子、アルキル基又はフェニル基を示し、nは1~ 3の整数を示す)を含有してなるポジ型感光性アニオン 電着絵料樹脂組成物、これを用いた電着塗装浴に関す

【0010】また、本発明は、前記電着塗装浴に導電性 基体を陽極として浸渍し、通電により電着塗装して導電 性基体上に電着塗装膜を形成し、その後活性光線を前記 電着塗装膜に画像状に照射し、露光部を現像により除去 することによりレジストパターンを形成させることを特 含むプリント回路板の製造法及び該製造法によって製造 されたプリント回路板に関する。

【0011】本発明によれば現像残りが解消されると同 時に電着性が向上し、また、カルボキシル基を有するべ ンソトリアソールが増感剤としての機能を示し光感度が 向上するという特長も合わせもつ。

【0012】以下、本発明について詳述する。ポジ型感 光性アニオン電着塗料樹脂組成物は例えば、前述したよ うに (A) キノンジアジド基をポリマー鎖中に導入した

材料を含む系などがあげられる。

【0013】 (A) の場合、キノンジアジド基をポリマ 一鎖中に導入する方法としては例えば1,2-ナフトキ ノンジアジドー4ースルホニルクロリド、1,2ーナフ トキノンジアジド-5-スルホニルクロリド、1,2-ナフトキノンジアジドー6-スルホニルクロリド、1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホニルプロミド、 1. 2-ペンゾキノンジアジド-4-スルホニルクロリ ド、1,2-ペンゾキノンジアジド-5-スルホニルク 徴とするレジストパターンの製造法、該製造法を工程に 40 ロリド、1,2-ベンゾキノンジアジドー6-スルホニ ルクロリド、1,2-ベンゾキノンジアジド-4-スル ホニルプロミドなどのキノンジアジドスルホン酸ハライ ドをポリマー中のヒドロキシル基やアミノ基などと脱塩 酸反応により縮合させて得ることができる。従ってベー スとなるポリマーにはアミノ基やヒドロキシル基の存在 が必要で、かつアニオン電着塗料とするためのカルボキ シル基を有していなければならない。このため、ポリマ ーにはいろいろな官能基を有する重合性モノマーを共重 合したアクリルポリマーが好ましい。

感光材料を含む系や(B)ポリマー結合剤とキノンジア 50 【0014】例えば、アミノ基を有する重合性モノマー

としては t e r t - プチルアミノエチルメタクリレー ト、イソプロピルアミノエチルアクリレート、tert ブチルアミノエチルスチレン、ヒドロキシル基を有す る重合性モノマーとしては2-ヒドロキシエチルメタク リレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、グリシ ジルメタクリレートにヒドロキシ安息香酸を反応させた モノマー、カルボキシル基を有する重合性モノマーとし てはアクリル酸、メタクリル酸などがあげられる。アミ ノ其もしくはヒドロキシル基を有する重合性モノマーの 共重合量は5~60重量%が好ましい。共重合量が5重 10 量%未満ではキノンジアジド基の導入量が少ないため光 感度が低くなり、また60重量%を越えると電着浴の水 分散安定性が低下する傾向がある。またポリマー中のカ ルポキシル基の濃度、すなわち酸価は30~250が好 ましい。酸価が30未満では電着浴の水分散安定性が低 下し、250を越えると、レジストの未露光部が現像液 に侵されやすくなる傾向がある。

【0015】ペースとなるポリマーには上記の重合性モ ノマー以外に一般的な重合性モノマー、例えばメチルメ タクリレート、エチルメタクリレート、n-プチルメタ 20 クリレート、エチルアクリレート、ロープチルアクリレ ート、スチレンなども適宜共重合することができる。

【0016】共重合する方法としては、有機溶媒中でア ソピスイソプチロニトリル、アゾピスジメチルパレロニ トリル、過酸化ペンゾイル等の重合開始剤を用いて一般 的な溶液重合により得ることができる。この場合、用い る有機溶媒は電着強料に供することを考えて、ジオキサ ン、メトキシエタノール、エトキシエタノール、メトキ シプロパノールなどの親水性有機溶媒を用いることが好 ましい。

【0017】ベースとなるポリマーの重量平均分子量は 4.000~150,000の範囲が好ましい。重量平 均分子量が4、000未満では電着塗装後の塗膜(感光 膜)の機械強度が低く、また150,000を越えると 電着塗装性が劣り、塗膜の外観が劣る傾向がある。

【0018】ポリマー中のアミノ基やヒドロキシル基と 前述のキノンジアジドスルホン酸ハライドとの反応は、 通常、有機溶媒中で塩基性触媒を用いて行なうことがで きる。塩基性触媒としては、炭酸水素ナトリウム、炭酸 等が挙げられ、その使用量はアミノ基もしくはヒドロキ シル基に対して20~300当量%用いられる。

【0019】反応温度は通常10~50℃の範囲が好ま しく、また反応時間は30分~5時間程度行なわれる。 反応終了後、反応液を水、または酸性水溶液に投入し、 前記の塩基性触媒を洗浄除去し、さらに精製を行なって キノンジアジド基をポリマー中に導入することができ る。

【0020】なお、今まで述べてきたように一旦ポリマ ーを合成したのちにキノンジアジド基を導入してもよい 50 電着塗装で形成できる電着塗料樹脂組成物であればすべ

し、より好ましくは予め前述のアミノ基やヒドロキシル 基を有する重合性モノマーにキノンジアジド基を導入し たのちにそれら重合性モノマーと他の重合性モノマーと を共重合してもよい。その際のキノンジアジド基の導入 方法 (反応条件) やその後の共重合条件などは前述した 場合と同様である。いずれにしてもキノンジアジド基を 有するポリマーであれば作製方法には制限はない。

[0021] 一方、(B) の場合、結合剤のポリマーは 通常、メタクリル酸もしくはアクリル酸を共重合したア クリルポリマーが好適である。このポリマーの酸価は、 前記、(A) の場合のベースとなるポリマーと同様の3 0~250が好ましい。また、このポリマーには(A) の場合のベースとなるポリマーと同様に一般的な重合性 モノマーを適宜共重合することができ、その際の共重合 条件や得られたポリマーの好ましい重量平均分子量の範 囲も同様である。

【0022】また、キノンジアジド基を分子内に複数個 有する化合物としては例えば、2,3,4-トリヒドロ キシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジドー 5-スルホン酸エステル、2、3、4、4~-テトラヒ ドロキシベンソフェノン-1,2-ナフトキノンジアジ ドー4ースルホン酸エステルなどのポリヒドロキシベン ソフェノンの1、2-ナフトキノンジアジド-4-スル ホン酸エステル類もしくは1,2-ナフトキノンジアジ ドー5-スルホン酸エステル類、3,5-ジヒドロキシ 安息香酸ラウリルー1、2-ナフトキノンジアジドー5 - スルホン酸エステル、2,3,4-トリヒドロキシ安 息香酸フェニルー1,2ーナフトキノンジアジドー4-スルホン酸エステルなどのポリヒドロキシ安息香酸エス テルの1.2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸 エステル類もしくは1,2-ナフトキノンジアジド-5 - スルホン酸エステル類,没食子酸-2-エチルヘキシ ルー1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エ ステル、没食子酸ラウリル-1,2-ナフトキノンジア ジドー5-スルホン酸エステル、没食子酸メチルー1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステルな どの没食子酸エステルの1,2-ナフトキノンジアジド -4-スルホン酸エステル類もしくは1,2-ナフトキ ノンジアジドー5ースルホン酸エステル類などがあげら ナトリウム、アンモニア、トリエチルアミン、ピリジン 40 れる。中でも役食子酸エステルにキノンジアジド基を有 する化合物は高感度で好ましい。結合剤のポリマーとこ れら化合物との配合量は、重量%で95/5~30/7 0の範囲が好ましい。結合剤のポリマーが95重量%を 越えると光感度が低下し、また30重量%未満では電着 浴の水分散安定性が低下する傾向がある。

> 【0023】以上、ポジ型感光性アニオン电着塗料樹脂 組成物についてキノンジアジド系を例にとり述べたが、 本発明はこれに限定されず、o-ニトロペンジルエステ ル系など、ポジ型の感光特性を有する感光膜をアニオン

て含まれる。

特開平5-117557

て含まれる。 (II) で表わされる化合物について以下に例示する。 (0024) 次に本発明の特徴となる一般式 (1) 及び 【化5】

(I-1)

$$(1-2)$$

(1-3)

.... --(化6)--- -- -(1-4)(1-5)

(1-6)

【化7】

$$([-7]$$

$$(I-8)$$

$$(1-9)$$

【化8】

$$(I-10)$$

$$([-11])$$

$$(1-12)$$

[化9]

$$(1-13)$$

$$(I-14)$$

$$(I-15)$$

(化10)

CH₂OH .

CH₂CH₂COOH.

COOCH₃

【化11】

11 ([-4]

(I-5)

12

【化18】

(1-6)

(1-7)

Ų١.

【0025】これらの化合物は1種以上混合して用いる こともできる。これら一般式(1)及び(11)で表わ される化合物の使用量(総量で)は前記、ポジ型感光性 アニオン電着塗料樹脂組成物100重量部に対して0. 1~15 重量部であることが好ましく、0.5~8 重量 部の範囲であることがより好ましい。使用量が0.1重 量部未満では現像残り解消及び電着性向上の効果が少な く、15重量部を越えると電着浴の安定性が低下する傾 向がある。

【0026】本発明におけるポジ型感光性アニオン電着 塗料樹脂組成物には、さらに増感剤、染料、顔料、可塑 剤、接着促進剤、表面平滑剤、分散剤、無機フィラーな ども適宜使用することができる。

【0027】以上述べた本発明になるポジ型感光性アニ オン電着途料樹脂組成物を電着塗料化するためには、ま ず前記の各種成分を親水性有機溶媒に均一に溶解せしめ ることが望ましいが、必ずしもこれにこだわる必要はな い。ここでいう親水性有機溶媒とは、例えばジオキサ ン、メトキシエタノール、エトキシエタノール、ジエチ レングリコールなどが挙げられる。これら溶媒は単独で も、また2種類以上混合してもよく、その使用量は全固 形分100重量部に対し300重量部以下の範囲が好ま LW.

【0028】次に、この溶液に塩基を加えてポリマー中 に含まれるカルボキシル基を中和することにより、組成 物の水溶化又は水分散化を容易にする。ここで用いる塩 基としては、特に制限はないが、例えばトリエチルアミ ン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、ジイ ソプロピルアミン、ジメチルアミノエタノール、モルホ リン、アンモニア、水酸化ナトリウム等が挙げられ、こ れらは単独もしくは2種以上混合して用いることができ る。これら塩基の使用量はポリマー中のカルポキシル基 1 当量に対して 0. 4~1. 0 当量が好ましい。 0. 4 当量未満では電着塗装浴での水分散安定性が低下し、 1. 0 当量を越えると電着塗装後の塗膜(感光層)厚が 薄くなり、貯蔵安定性も低下する傾向があり好ましくな 50 一ンの解像度が低下することがある。

【0029】次に水を加えてポジ型感光性アニオン電着 塗料樹脂組成物を水に溶解もしくは分散させて電着塗装 浴を作製する。電着塗装浴の固形分は通常5~20重量 %、またpHは6.0~9.0の範囲が好ましい。pH 20 が 6. 0未満では分散が悪化し電気泳動しにくくなるお それがあり、pHが9、0を越えると一旦電着した膜が 再溶解し、結果として膜が形成されないことがある。 p Hを上記の好ましい範囲に合わせるために後から前記の 塩基を加えて調節してもよい。

[0030] また、ポジ型感光性アニオン電着塗料樹脂 組成物の水分散性や分散安定性を高めるために、非イオ ン、陽イオン、陰イオン等の界面活性剤を適宜加えるこ ともできる。さらに、電着塗装時の塗布量を多くするた めにトルエン、キシレン、2-エチルヘキシルアルコー 30 ル等の疎水性溶媒も適宜加えることができる。

【0031】このようにして得られた電着塗装浴を用い て基板表面 (この場合、少なくとも基板表面は鉄、アル ミニウム、銅、亜鉛、その他金属及び合金等の金属など で罹われるなど導電性であることが必要)に電着塗装す るには、基板を陽極として電着塗装浴中に浸漬し、例え ば、50~400 Vの直流電圧を10秒~5分間印加し て行なわれる。このときの電着塗装浴の温度を15~3 0℃に管理することが望ましい。

[0032] 電着塗装後、電着塗装浴から被塗物を引き 上げ水洗、水切りした後、熱風等で乾燥される。この 際、乾燥温度が高いとポジ型感光性アニオン電着塗料樹 脂組成物中の感光基が分解するおそれがあるので、通常 120℃以下で乾燥することが好ましい。

【0033】こうして得られた塗膜(感光層)の厚みは $2\sim50 \mu m$ が好ましい。膜厚が $2\mu m$ 未満では耐現像 液性が低く、また例えばプリント回路板の製造に用いる 場合には、レジストパターンを形成後エッチング処理し た際に、耐エッチング液性やエッチファクターが劣る傾 向があり、また膜厚が50μmを越えるとレジストパタ

【0034】ついで該塗膜に活性光線を画像状に照射 し、さらに、場合により後加熱を行なったのち、現像に より露光部を除去してレジストパターンを得ることがで きる。活性光線の光源としては、波長300~450n mの光線を発するもの、例えば水銀蒸気アーク、カーボ ンアーク、キセノンアーク等が好ましく用いられる。

【0035】現像は通常、水酸化ナトリウム、炭酸ナト リウム、水酸化カリウム、メタケイ酸ナトリウムなどの アルカリ水を吹きつけるか、アルカリ水に浸漬するなど して行なわれる。

[0036]

【実施例】以下、実施例により本発明を説明する。

2-ヒドロキシエチルアクリレート116g及び1,2 ーナフトキノンジアジドー5-スルホン酸クロリド37 5gをジメチルホルムアミド1500mlに溶解した液 を撹拌しながら5℃に設定し、これにトリエチルアミン 140gを30分かけて滴下した。滴下後、5℃でさら に20時間反応させた後、反応物を0.1Nの希塩酸水 溶液に注入し、得られた沈殿物をさらに精製、乾燥し、 2-ヒドロキシエチルアクリレートと1,2-ナフトキ ノンジアジドー5-スルホン酸とのエステル化合物(重 合性モノマー)、134gを得た。

【0037】次に、撹拌機、還流冷却器、温度計、滴下 ロート及び窒素ガス導入管を備えたフラスコにジオキサ ン1,130gを加え撹拌しながら窒素ガスを吹き込み 60℃の温度に加温した。温度が60℃の一定になった ところで、上記のエステル化合物(重合性モノマー)2 80g、メタクリル酸169g、メチルメタクリレート 81g、nープチルアクリレート470g及びアゾビス 30 ジメチルバレロニトリル15gを混合した液を3時間か けてフラスコ内に滴下し、その後60℃で3時間撹拌し ながら保温した。3時間後にアゾピスジメチルパレロニ トリル5gをジオキサン100gに溶かした溶液を10 分かけてフラスコ内に滴下し、その後再び4時間60℃ で撹拌しながら保温した。

【0038】このようにして得られた共重合ポリマー (P-1) の重量平均分子量は51,000、酸価は1 11であった。またポリマー溶液の固形分は45.3重 量%であった。次に、このポリマー溶液650gに前記 *40* のカルポキシル基を有するベンゾトリアゾール誘導体 (1-1) 3gを加えて溶解し、さらにトリエチルアミ ン36gを加えて中和したのち、溶液を撹拌しながらイ オン交換水2.900gを徐々に滴下して加えていき、 電着塗装浴(pH7.2)を得た。

【0039】 実施例2

tertープチルアミノエチルメタクリレート210 g. ジオキサン120g及びトリエチルアミン150g の混合液を40℃に加温し、撹拌しながら1,2ーナフ ジオキサン1250gに溶かした溶液を約2時間かけて 滴下し、その後40℃で4時間保温した。

14

【0040】反応物を0.1Nの希塩酸水溶液に注入 し、得られた沈殿物をさらに精製、乾燥し、tert-プチルアミノエチルメタクリレートと1,2-ナフトキ ノンジアジドー5-スルホン酸との化合物(重合性モノ マー)、168gを得た。

【0041】次に実施例1の場合と同様なフラスコにジ オキサン1、130gを加え撹拌しながら窒素ガスを吹 10 きこみ60℃の温度に加温した。温度が60℃一定にな ったところで、上配の化合物(重合性モノマー)305 g、アクリル酸64g、メチルメタクリレート150 g、n-プチルアクリレート481g及びアゾピスジメ チルパレロニトリル30gを混合した液を3時間かけて フラスコ内に滴下し、その後60℃で3時間撹拌しなが ら保温した。3時間後にアゾピスジメチルパレロニトリ ル10gをジオキサン100gに溶かした溶液を10分 かけてフラスコ内に滴下し、その後再び4時間60℃で 撹拌しながら保温した。

【0042】このようにして得られた共重合ポリマー (P-2) の重量平均分子量は34,000、酸価は4 9であった。またポリマー溶液の固形分は45.1重量 %であった。

【0043】次にこのポリマー溶液650gに前記のカ ルポキシル基を有するベンゾトリアゾール誘導体(I-26)、8gを加えて溶解し、さらにトリエチルアミン 20gを加えて中和したのち、溶液を撹拌しながらイオ ン交換水2,900gを徐々に摘下して加えていき、電 着塗装浴(pH7.9)を得た。

【0044】 実施例3

損拌機、還流冷却器、温度計、滴下ロート及び窒素ガス 導入管を備えたフラスコにメトキシプロパノール900 gを加え、撹拌しながら窒素ガスを吹き込み、90℃の 温度に加温した。温度が90℃一定になったところでア クリル酸141g、メチルメタクリレート320g、n ープチルアクリレート539g及びアゾピスイソプチロ ニトリル10gを混合した液を2.5時間かけてフラス . コ内に滴下し、その後、3時間90℃で撹拌しながら保 温した。3時間後にアゾピスイソプチロニトリル3gを メトキシプロパノール100gに溶かした溶液を10分 かけてフラスコ内に滴下し、その後再び4時間90℃で 撹拌しながら保温した。

【0045】このようにして得られたポリマー (P-3) の重量平均分子量は35,000、酸価は109で あった。またポリマー溶液の固形分は50.1重量%で あった。

【0046】次にこのポリマー溶液500gに没食子酸 -2-エチルヘキシルの3つのヒドロキシル基に1,2 -ナフトキノンジアジドー5ースルホン酸でエステル化 トキノンジアジド-5-スルホン酸クロリド320gを 50 した化合物(Q-1)45g、前配のカルポキシル基を

15

有するベンゾトリアゾール誘導体(I-1)5g、及びメトキシプロパノール250gを加えて均一溶被とした。この溶液にトリエチルアミン22gを加えて中和し、次いで水2,300gをゆっくり滴下しながら水分散させ電着塗装浴(pH7.3)を得た。

【0047】 実施例4

実施例3と同様の装置を備えたフラスコにメトキシプロパノール1,130gを加え、撹拌しながら窒素ガスを吹き込み、90℃の温度に加温した。温度が90℃一定になったところで、メタクリル酸108g、メチルメタ 10クリレート230g、nープチルアクリレート562g、2ーヒドロキシエチルアクリレート100g及びアゾピスイソプチロニトリル10gを混合した液を2.5時間かけてフラスコ内に滴下し、その後90℃で3時間撹拌しながら保温した。3時間後にアゾピスイソプチロニトリル3gをメトキシプロパノール100gに溶かした溶液を10分かけてフラスコ内に滴下し、その後再び90℃で4時間撹拌しながら保温した。

【0048】 このようにして得られたポリマー (P-4) の重量平均分子量は52,000、酸価は72であ 20った。また樹脂溶液の固形分は44.8重量%であった。

【0049】次にこのポリマー溶液500gに没食子酸ラウリルの3つのヒドロキシル基を1,2ーナフトキノンジアジド-5-スルホン酸でエステル化した化合物(Q-2)70g、前配のカルボキシル基を有するベンソトリアゾール誘導体(I-26)10g、及びメトキシプロパノール200gを加えて均一溶液とした。この溶液にトリエチルアミン23gを加えて中和し、次いで水2,300gをゆっくり滴下しながら、水分散させ電30 着塗装浴(pH7.5)を得た。

【0050】 実施例5

実施例1のうち、ペンゾトリアゾール誘導隊(I-1)の替わりに(I-26)を加えた点を除いて、すべて実施例1と同様の材料を用いて、同様の方法で電着塗装浴を得た。

【0051】 実施例6

実施例2のうち、ベンソトリアソール誘導隊(I-2 6)の替わりに (I-1)を加えた点を除いて、すべて 実施例2と同様の材料を用いて、同様の方法で電着塗装 40 浴を得た。

【0052】 実施例7

実施例3で用いたポリマ (P-3) 溶液500gに、前記化合物 (Q-2) 60g、前記のカルポキシル基を有するペンゾトリアゾール誘導隊 (I-26) 5g、及びメトキシプロパノール200gを加えて均一溶液とした。この溶液にトリエチルアミン22gを加えて中和し、次いで水2300gをゆっくり適下しながら水分散させ、電着塗装浴 (pH7.6) を得た。

【0053】実施例8

16

実施例4で用いたポリマ (P-4) 溶液500gに、前 記化合物 (Q-2) 70g、前記のカルボキシル基を有 するペンゾトリアゾール誘導隊 (I-1) 10g、及び メトキシプロバノール200gを加えて均一溶液とし た。この溶液にトリエチルアミン23gを加えて中和 し、次いで水2300gをゆっくり適下しながら水分散 させ、電着塗装浴 (pH7.7) を得た。

【0051】比較例1

実施例1のうち、ベンゾトリアゾール誘導体(I-1) を加えない点を除いて、すべて実施例1と同様の材料を 用いて同様の方法で電着塗装浴を得た。

[0055] 比較例2

実施例4のうち、ベンソトリアゾール誘導体(I-2 6)を加えない点を除いて、すべて実施例4と同様の材料を用いて、同様の方法で電着強装浴を得た。

【0056】比較例3

実施例3のうち、ベンソトリアゾール誘導体(I-1)の替わりに分子内にカルボキシル基を有さない単なるベンゾトリアゾールを5g加えた点を除いて、実施例3と同様の材料を用いて、同様の方法で電着塗装浴を得た。

【0057】 実施例1~4及び比較例1~3の各電着塗装浴にガラスエポキシ銅張積層板(日立化成工業(株)製、MCL-E-61)を隔極として、ステンレス板(SUS304) (形状200mm×75mm×1mm)を陰極として浸漬し、25℃の温度で直流電圧を3分間印加し、上記銅張積層板の表面に電着塗装膜(感光膜)を形成した。この後、水洗、水切り後80℃で15分乾燥した。このときの印加電圧と電着塗装膜の膜厚との関係を表1に示す。

【0058】次いで、これらの登膜にフォトレジストマスクを介して3KW超高圧水銀灯を画像状に露光した後、1%の炭酸ナトリウム水溶液で現像した。それぞれの光感度を評価するために、ステップタブレットで4段を得るための露光量を測定した(結果を表1に示す)。また、現像残りの有無を確認する目的で現像後の基板を1%の塩化銅水溶液に1分間浸漬し、未露光部の基板のエッチングされた程度を目視で観察した。その結果を表1に示した。

【0059】表1から、本発明になるカルポキシル基を有するペンゾトリアゾール誘導体を含んだ実施例1~8は、それを含まない比較例1~2に比べていずれも低電圧で同等の膜厚が得られ、電着性が向上していることが分かる。また光感度も、実施例1~8は比較例1~2に比べて高い。現像残りについては、本発明になるカルボキシル基を有するペンゾトリアゾール誘導体を含まない比較例1~2は、完全にはエッチングされず、部分的に現像残りがあるのに対し、実施例1~8はすべて完全にエッチングされ、現像残りは皆無であることが分かる。

[0060] 一方、比較例3は本発明になるカルボキシ 50 ル基を有するペンゾトリアゾール誘導体の替わりにカル 17

ボキシル基を有さない単なるベンソトリアソールを添加した例であるが、表1に示すごとく、電着性は比較例1~2と同等で実施例1~8に見られるような電着性向上の効果は見られない。また、現像残りについては、未添加の場合(比較例1~2)に比べてむしろ悪化し、実施例1~4の場合に見られる効果とは正反対になることが分かる。このことは単なるキレート剤の添加では実施例1~8に示された数々の効果は発揮できないこと、換雪*

*すれば、実施例1~8に見られるいろいろな特性向上は、カルボキシル基を有するベンゾトリアゾール誘導体という特異な化合物の添加によってもたらされた大きな特長といえる。もちろん、現像後に得られた実施例1~8のレジストバターンは、解像度50μmの良好なレジスト形状を有していた。

18

[0061]

【表1】

表1 電着性、光緒度及び単像残り

氷り4	化合物	ペンゾトリア ゾー ル無海体	印加電圧	電常塗装膜の 路屋(4 m)		エッチング性リ
P-1	なし	I - 1	100	8	150	0
P-2	なし	1 - 2 6	80	. 8 .	180	0
P-3	Q-1	1-1	75	7	140	0
P-4	Q-2	1-26	70	7	140	0
P-1	なし	I - 2 6	9 5	8	160	0
P-2	なし	I + 1	9.5	В	150	0
P-8	Q-2	I - 2 6	70	. 7	140	0
P-4	Q-2	1-1	. 75	7	140	0
P-1	なし	tel	180	8	200	×
P-4	Q-2	なし	170	7	180	×
P-3	Q-1	ベンゾトリア	170	7	170	××
	P-1 P-2 P-3 P-4 P-1 P-2 P-8 P-4	P-1 & L P-2 & L P-3 Q-1 P-4 Q-2 P-1 & L P-2 & L P-8 Q-2 P-4 Q-2 P-1 & L P-4 Q-2	ソール誘導体 ソール誘導体 P-1 なし I-1 I-2 6 P-3 Q-1 I-1 P-4 Q-2 I-2 6 P-1 なし I-1 P-8 Q-2 I-1 P-1 なし P-4 Q-2 X し P-4 Q-2 X し P-4 Q-2 X し D-4 Q-4 Q	ソール誘導体 (V) P-1 なし I-1 100 P-2 なし I-26 90 P-3 Q-1 I-1 75 P-4 Q-2 I-26 70 P-1 なし I-26 96 P-2 なし I-1 95 P-8 Q-2 I-1 75 P-1 なし なし 180 P-4 Q-2 なし 170 P-3 Q-1 ベンゾトリア 170	ソール誘導体 (V) 底厚(am) P-1 なし I-1 100 8 P-2 なし I-26 90 8 P-3 Q-1 I-1 75 7 P-4 Q-2 I-26 70 7 P-1 なし I-26 95 6 P-2 なし I-1 95 8 P-8 Q-2 I-26 70 7 P-4 Q-2 I-1 75 7 P-1 なし なし 180 8 P-4 Q-2 なし 170 7 P-3 Q-1 ベンゾトリア 170 7	P-1 なし I-1 100 8 150 P-2 なし I-26 90 8 180 P-3 Q-1 I-1 75 7 140 P-4 Q-2 I-26 70 7 140 P-1 なし I-26 95 8 160 P-2 なし I-1 95 8 150 P-8 Q-2 I-26 70 7 140 P-4 Q-2 I-1 75 7 140 P-1 なし なし 180 8 200 P-4 Q-2 なし 170 7 180 P-3 Q-1 ベンゾトリア 170 7 170

住し、エッチング性 〇 : 度好(抵象残りなし)

× :不良(現象類りあり)

××:極めて不良(現像悪り多い)

[0062]

【発明の効果】本発明のポジ型感光性アニオン電着整料 樹脂組成物、これを用いた電着塗装浴及びレジストパタ ーンの製造法は、従来に比べて電着性が向上し、得られ た電着塗装膜(感光膜)の光感度も高く、現像後に露光 部の現像残りが全くない優れたものである。本発明のブ リント回路板の製造法によれば、高解像度のレジストパ ターンを得ることができるので、極めて高品質のプリント回路板が得られる。本発明のポジ型感光性アニオン電 着塗料樹脂組成物、これを用いた電着塗装浴及びレジストパターンの製造法は、レジストをレリーフとして使用 したり、銅張積層板を基体としてエッチング又はメッキ 用のフォトレジストの形成に適用することができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G03F 7/039

H05K 3/06

H 6921-4E

(72)発明者 加藤 琢邸

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化成工業株式会社山崎工場内